

PBI（ポリベンゾイミダゾール）樹脂の射出成形

概要・品質・性能	<p>溶融するが流動しない特性により圧縮成形法が用いられるPBI（ポリベンゾイミダゾール）樹脂を射出成形することで半導体および液晶ディスプレイ製造用フォトレジスト関連製品を製造する技術。</p> <p>PBI樹脂は600℃を超える熱分解温度を持ち、荷重たわみ温度は435℃、ガラス転移点が418℃と樹脂材料の中で最高の耐熱性を持ち、機械的強度にも優れ、イオン不純物の少ない高機能スーパーエンプラ。NASA（米航空宇宙研究所）、AFML（米航空材料研究所）およびセラニーズコーポレーション（ヘキストグループ）が共同で開発・企業化。消防士向けの防護服として製品化され、世界中で使用されている。今後は航空機関連製品、電気自動車関連製品に用途が拡大すると見込まれる。</p>	<p>PBI樹脂製部品</p> 
用途	<p>(1) 半導体および液晶ディスプレイ製造用フォトレジスト関連製品</p> <p>(2) 消防士用防護服</p> <p>(3) 航空機・電気自動車関連製品</p>	<p>技術移転</p> <p>(1) 形態 部品・製品の供給、共同研究開発、研究開発委託</p> <p>(2) 相手先 射出成形品を使用する企業</p> <p>(3) 地域 国内に限る</p>
実用化・情報	<p>[試作・実験] 完了</p> <p>[製造・販売実績] 有り</p> <p>[技術情報の提供] パンフレット、特許公報等、サンプル</p> <p>[情報提供者] (有)八正精工 製造部 南館 正士</p> <p>[連絡先] (公財)りそな中小企業振興財団 TEL 03-3444-9541 FAX 03-3444-9546</p>	<p>特許出願中</p> <p>出願番号：特願2014-112547</p> <p>出願日：平成26年5月30日</p> <p>特許権者：南館 正士</p> <p>特許等</p>